

光部品生産技術部会 講演要旨

開催日：2024年12月11日（水） <2024-3 ①>

テーマ：「Tool Visualizer について」

講演者：神藤建太氏（DMG 森精機株式会社 応用技術開発統括部 統括部長）

DMG MORI の LASERTEC シリーズは、対象とするアプリケーションに応じて複数の機種が開発されており、それぞれの機種は異なる特性を有している。本講演では、これらの機種の対象領域、機械構造、加工制御機能について詳述するとともに、工具業界におけるレーザ加工の適用事例を研削加工や放電加工との比較を通じて解説した。レーザ加工が適用される分野としては、主にダイヤモンドチップの切り出し、母材へロウ付けされたダイヤモンドチップや各種インサートへの刃付けに関連する技術が挙げられる。さらに、超硬材に対する超短パルスレーザ（フェムト秒レーザ）を搭載した機種による加工事例についても紹介した。

LASERTEC シリーズによるレーザ加工技術は、近年急速に進展している機械加工の自動化およびデジタル化の流れを取り入れ、工程集約を実現しつつ、更なる技術的発展を遂げるものと考えられる。